

#### **EAGLE 5.11.0 Kurzanleitung**

#### Inhalt

Installation der persönlichen Einstellungen	1
Erstellung eines Schaltplans	
Erstellung einer Leiterplatte	
Bohrdurchmesser für Pads	
Beispielprojekt	
Erstellung eines Device, Package, Symbol durch kopieren und abändern eines vorhandenen	
Device	7
Hilfreiche Scripts und ULPs	9
Kurzbeschreibung der Funktionstasten und Befehle	9
Layer	10
Hinweis zu den neuen Laver	

## Installation der persönlichen Einstellungen Beim ersten Einstieg sind folgende Schritte auszuführen:

Eagle 5.11.0 installieren	Verzeichnis "P:\oeffentlich\_anw	vendungen\eagle-5.11.0\lnstall\eagle-5.11.0_init.bat" starten.
Optionen/Verzeichnisse	Libraries:	P:\oeffentlich\_anwendungen\eagle-5.11.0\htl-lbr
	User-Language-Programme:	P:\oeffentlich\_anwendungen\eagle-5.11.0\ulp
	Scripts:	P:\oeffentlich\_anwendungen\eagle-5.11.0\scr
	CAM-Jobs:	P:\oeffentlich\_anwendungen\eagle-5.11.0\cam
	Projects:	M:\eagle\projects

Begriffe: LMT ... Linke Maustaste RMT ... Rechte Maustaste



## **Erstellung eines Schaltplans**Zuerst für jedes neue Projekt eine eigene Mappe anlegen! Regelmäßig speichern!

Datei/Neu/Project		Projektname eingeben und mit Enter-Taste bestätigen.
Datei/Neu/Schematic		Sofort unter dem Projektnamen abspeichern
Bibliothek/Benutzen		Benötigte Bibliotheken unter P:\oeffentlich\_anwendungen\eagle-5.11.0 öffnen, z.B. user_frame.lbr, user_analog.lbr, user_ic.lbr, user_elektro-lbr
Bearbeiten/Add	₹	Zeichenblatt einfügen aus user_frame->HTL-A4-H, HTL-A4-V, HTL-A3-H oder HTL-A3-V. Auch di Auswahl des Zeichenblatts für das Layout wird bereits festgelegt HTL-A4-H, HTL-A4-V, HTL-A3-H oder HTL-A3-V. Jede Kombinaton ist möglich.  Auf Koordinate 0,0 ablegen.
Zeichnen/Text	Т	Zeichenblatt Schematic [Hinweis: die ULP "HTL_Set_Project_Globale_Attributtes.ulp" setzt die globalen Attribute für die Beschriftung auch für das Zeichenblatt des Layouts. Projektname: Schriftart: Size: 0.2, Ratio: 8 %, Font: Vector, Layer 100 Name: Schriftart: Size: 0.1, Ratio: 8 %, Font: Vector, Layer 100 Title, Datum und Sheet werden mit Datei/Speichern – F2 eingefügt
Bearbeiten/Change	<i>≯</i>	Strg + LMT Wählt das Elementaus und verschiebt es auf den nächsten Rasterpunkt. Alt + LMT bewegt das Element im feinen Raster.
Bearbeiten/Move (F7)	.1.	Diad. (Ownes) was skieless.
Bearbeiten/Group Bearbeiten/Move	1,	Block (Gruppe) verschieben: Zuerst eine Gruppe erzeugen,
200.00.00.00.00	<del>+ 1 +</del>	dann mit Strg + RMT verschieben.
2) Symbole lader	1	
Ansicht/Raster		Raster einschalten, im Raster 0.1 Inch zeichnen! (Raster: 0.1, Multiplikator: 1, Alt: 0.01 Inch)
Bearbeiten/Add	1	Symbol aus Bibliothek auswählen und mit LMT platzieren. Symbol mit RMT drehen. Beenden mit <i>Stop</i> . (Esc)
Bearbeiten/Rotate	7	Symbol drehen
Bearbeiten/Delete	×	Symbol löschen
Bearbeiten/Invoke	2.0	Damit werden bei einem IC die verborgenen Anschlusspins der Versorgungs-spannung sichtbar gemacht: LMT auf Gate PWRN OK
3) Elektrische Ve	rbindu	ngen zeichnen
Zeichnen/Net		Elektrische Verbindungen zeichnen. Setzt automatisch die Junctions.
Bearbeiten/Name	R2	Masseleitung mit LMT anklicken und mit GND beschriften.
4) Symbole besc	1011	
Bearbeiten/Name	R2	Referenzbezeichner abändern (wenn nötig)
Bearbeiten/Value	TOk R2	
	lok	Value eintragen
Bearbeiten/Smash	E.	Verschieben von Value und RefDes: Smash löst Value und RefDes vom Symbol.
5) Bus zeichnen		
Zeichnen/Bus		Der gezeichnete Bus stellt noch keine Verbindung dar
Bearbeiten/Name Zeichen/Label	R2 lok ABC	Dem Bus einen Namen zufügen, z.B. Bus1:A[07],D[04] Bus mit Busnamen beschriften
Zeichnen/Net Zeichen/Label	ABC	Bus mit Bauteil verbinden. Immer vom Bus beginnend zeichnen. Netz mit Netznamen beschriften
6) zwei Schaltplä	ne – ei	ne Leiternlatte
2. Sheet einfügen	1/1	Sheet new
Zeichnen/Label	ABC	Netze, die beide Sheets verbinden mit Label beschriften
Bearbeiten/Name	R2	Netze, die beide Sheets verbinden erhalten den gleichen Netznamen
Bearbeiten/Invoke	2.0	Beispiel: Stecker X1G\$1 ist auf Sheet1/2 und X1G\$2 soll auf Sheet2/2 Sheet2/2: Invoke und X1 eingeben, aus Popup-Menue X1G\$2 auswählen
7) Schaltplan prü	ifen	
Werkzeuge/Schaltplan Prüfen	<b>•</b>	ERC (Electrical Rule Check): prüft den Schaltplan auf Fehler.
8) Schaltplan dru	ıcken	
Datei/Drucken		Optionen: ☑ Schwarz (druckt alle Farben schwarz), ☑ Gefüllt (druckt alle Füllmuster schwarz)
	·	Skalierungsfaktor 1 (
0) Stückliste erst	ollon	Oraniciangolarion i ( — )
<ol><li>Stückliste erst</li></ol>	ellen	Das Skript HTL_Create_BillOfMaterial.ulp erzeugt eine Stückliste im CSV-, TXT- oder HTML-



Format. Eine Materialdatenbank (csv-Datei) kann eingebunden werden.

## Erstellung einer Leiterplatte Zuerst für jedes neue Projekt eine eigene Mappe anlegen! Regelmäßig speichern!

1) Leiterplatte a	us Schal	tplan erzeugen
	÷	Erstellt die Leiterplattendatei aus den Schaltplandaten.
2) Leiterplattenu	ımriss ir	nnerhalb der Zeichenfläche erstellen
		Die ULP "HTL_Create_Board.ulp" erzeugt den Leiterplattenumriss, die Beschriftungen sowohl auf der Löt- als auch auf der Bestückungsseite und die Bemaßung. Hinweis: Den Leiterplattenumriss in den Ursprung (0 0) zu legen ist vorteilhaft.
Ansicht/Raster		Raster einschalten, möglichst mit 0.05 Inch zeichnen!
Zeichnen/Wire		Den neuen Leiterplattenumriss zeichnen. Width: 0.01, Style: Continuous, Layer 20 (Dimension)
Grid Inch		Die Bauteile besitzen meist Pads im Inch-Raster. Das Skript (HTL_Set_Grid_0.05inch.scr) erleichtert das Umschalten auf die Standardeinstellung. (Linien-Raster)
Grid mm	Gen : :: Inn : ::	Der Leiterplattenumriss ist im mm_Raster zu zeichen. Das Skript (HTL_Set_Grid_1mm.scr) erleichtert das Umschalten auf die Standardeinstellung. (Punkt-Raster)
3) Bauteile platz	ieren	
Bearbeiten/Move F7	4	LMT: Bauteile auswähhlen und verschieben RMT: Drehen des selektierten Bauteils. Strg + LMT Wählt das Elementaus und verschiebt es auf den nächsten Rasterpunkt. Alt + LMT bewegt das Element im feinen Raster.
Zeichnen/Via	•	Befestigungsbohrungen zeichnen: 0.2 Inch von jeder Ecke
Zeichnen/Circle	0	Um jede Befestigungsbohrung die Freihaltefläche einzeichnen. Layer 16 (Bottom)
Bearbeiten/Change /Diameter /Drill /Shape	Þ	Pad bearbeiten Siehe Bohrdurchmesser für Pads! Siehe Bohrdurchmesser für Pads! Pad-Form auswählen.
Bearbeiten/Smash	ı	Verschieben von Value und RefDes: Smash löst Value und RefDes vom Symbol.
4) Elektrische V	erbindu	ngen zeichnen
Bearbeiten/Route	٦	Elektrische Verbindungen zeichnen. Signalleitungen: Width 0.024, 45°/ Stromversorgung: Width 0.04, 45°
		Auswahl des Knickwinkels:
Bearbeiten/Ripup	1	Elektrische Verbindungen löschen.
Bearbeiten/Change	15	Nachträgliches Ändern z.B. der Leiterbreite
Zeichnen/Text	Т	Leiterplatte auf Layer Bottom (wird automatisch gespiegelt) und Top beschriften: Name der Leiterplatte, Lötseite (bot oder top), Loginname, Leiterplattenmaß, HTL-Logo (auf einer Seite) [Hinweis: die ULP "HTL_Create_Board.ulp" erzeugt diese Beschriftung, Schhneidkreuze und auch die Bemaßung] Schriftart: Size: 0.076, Ratio: 16 %, Font: Vector.
Zeichnen/Rect		Eckmarkierungen zeichnen, Layer: Bottom bzw. Top, Größe 2.0 x 9.0 mm (0.078 x 0.35 Inch)
5) Symbole beso	chriften	
Bearbeiten/Value	IQk	Falls nicht aus dem Schaltplan übernommen: Value eintragen
Bearbeiten/Smash	200	Verschieben von Value und RefDes: Smash löst Value und RefDes vom Symbol.
6) Massefläche		
Zeichnen/Polygon	×	Netzname eingeben, Polygon zeichnen  Layer 16 (Bottom) Width: 0.016, Spacing: 0.05, Isolate: 0.024  Mit Ratsnest-Icon Polygon ausfüllen.
Bearbeiten/Ripup	1	Polygon unsichtbar: <i>Ripup</i> , dann mit LMT Polygon-Umrandung anklicken Mit HTL_Polygon_OFF.scr und HTL_Polygon_ON.scr kann das Ausfüllen der Masseflächen ein und ausgeschaltet werden.
7) Zeichenblatt		
Bearbeiten/Add	±1€-	Da das Zeichenblatt mit dem Schaltplan eingefügt wurde, muss es nur mer richtig platziert werden. Hinweis: Mit "Replace" kann das Zeichenblattformat geändert werden .
Zeichnen/Text	Т	Layer 101 (tFrame): Zeichenblatt Bestückungsplan Layer 102 (bFrame): Zeichenblatt Bohrplan Bei Verwendung des ULP "HTL_Set_Project_Globale_Attributtes.ulp" ist der der Schriftkopf bereits ausgefüllt. Schriftkopf ausfüllen (Projektname, Name): Projektname: Schriftart: Size: 0.2, Ratio: 8 %, Font: Vector Name: Schriftart: Size: 0.1, Ratio: 8 %, Font: Vector Title und Datum werden mit Datei/Speichern – F2 eingefügt



8) Bemassung		
Zeichnen/Wire		Masslinien zeichnen. Layer 47 (Measures), Width 0.01
Zeichnen/Text	T	Maße beschriften, gespiegelt
	1	Schriftart: Size: 0.07, Ratio: 8 %, Font: Vector
9) Bohrlegende		
Bohrsymbole anpassen		Mit "Optionen / Einstellungen / Bohrsymbole / Erzeugen" werden die Bohrsymbole aktualisiert. Die
		Anzeige der Durchmesser erfolgt in der Anzeigeeinstellung des Rasters.
ULP_ausführen	(2).	HTL_Create_Drilling.ulp (oder
		Die Bohrlegende wird neben dem Blattrahmen angelegt.
Bearbeiten/Group	::	
		Bohrlegende gruppieren, mit E3 -Strg-RMT spiegeln und mit ++-Strg-RMT auf das Zeichenblatt
L # - ala - and - a D - land - and - ala		verschieben. Die Bohrlegende liegt auf dem Layer 144 Drill_legend.
Löschen der Bohrlegende		Mit dem Skript HTL_Delete_Drilling.scr kann die Bohrlegende wieder vollständig gelöscht werden.
10) Drucken (Boh	rplan)	
Datei/Drucken	Æ.	Layer: 20 (Dimension), 22 (bPlace), 44 (Drills), 45 (Holes), 47 (Measures)
		Optionen: ☑ Spiegeln, ☑ Schwarz (druckt alle Farben schwarz), ☑ Gefüllt (druckt alle Füllmuster
	•	schwarz), Skalierungsfaktor 1 ( )
11) Drucken (Best	tückur	
Datei/Drucken		Layer: 20 (Dimension), 21 (tPlace), 25 (tNames), 27 (tValues), 51 (tDocu), 101 (tFrame)
(Top)		Optionen: ☑ Schwarz (druckt alle Farben schwarz), ☑ Gefüllt (druckt alle Füllmuster schwarz),
5		Skalierungsfaktor 1 ( )
Datei/Drucken (SMD -> Bottom)		Layer: 20 (Dimension), 22 (bPlace), 26 (bNames), 28 (bValues), 52 (bDocu), 102 (bFrame) Optionen: ☑ Spiegeln, ☑ Schwarz (druckt alle Farben schwarz), ☑ Gefüllt (druckt alle Füllmuster
(SMD -> Bollom)		Optionen. M Spiegein, M Schwarz (druckt alle Farbert Schwarz), M Geruiit (druckt alle Fullinuster
		schwarz), Skalierungsfaktor 1 (
12) Drucken (Layo	out)	
Datei/Drucken	/=J.	Layer: 16 (Bottom), 17 (Pads), 18 (Vias), 102 (bFrame)
(Bottom)		Optionen: 🗹 Spiegeln, 🗹 Schwarz (druckt alle Farben schwarz), 🗹 Gefüllt (druckt alle Füllmuster
		schwarz), Skalierungsfaktor 1 (HTL_Print_Layout_bottom.scr)
Datei/Drucken	<i>a</i>	Layer: 1 (Top), 17 (Pads), 18 (Vias), 101 (tFrame)
(Top)		Optionen: ☑ Schwarz (druckt alle Farben schwarz), ☑ Gefüllt (druckt alle Füllmuster schwarz),
	-	Skalierungsfaktor 1 (HTL_Print_Layout_top.scr)
13) Gerber-File er	steller	
Datei/CAM-Prozessor		CAM-Prozessor starten
Datei/Öffnen/Job		Job gerb274x.cam öffnen
Lötseite		Layer 16 (Bottom), Layer 17 (Pads), Layer 18 (Vias) sind aktiv.
		Schritt ausführen erzeugt die Datei .sol

#### **Bohrdurchmesser für Pads**

1 Inch = 1000 mil = 25,4 mm

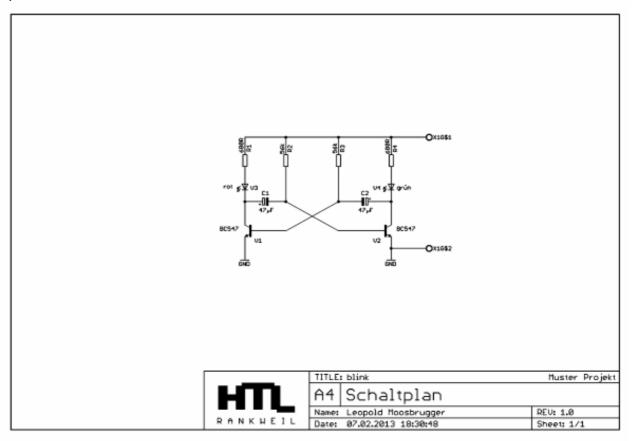
Umrechnung: mm = Inch x 25,4 Inch = mm / 25,4

Bohrdurchmesser	Drill	Diameter	Anwendung
0,8 mm	0,023622 Inch	min. 0,07 Inch	R 0,25 W, kleine C, Transistoren, IC
1,1 mm	0,027559 Inch	min. 0,1 Inch	R 0,5 W, Elkos, Dioden
1,3 mm	0,031496 Inch	min. 0,1 Inch	Klemmen, Potis
3,2 mm	0,043307 Inch	0,1 Inch	Befestigungsbohrungen (M3)

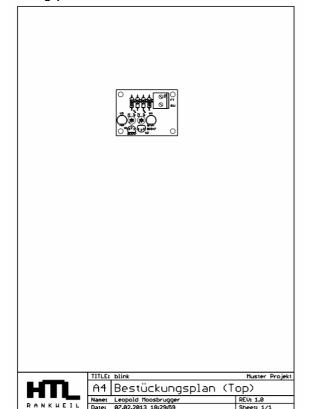
Hinweis: 8-eckige Blenden sollten vermieden werden.



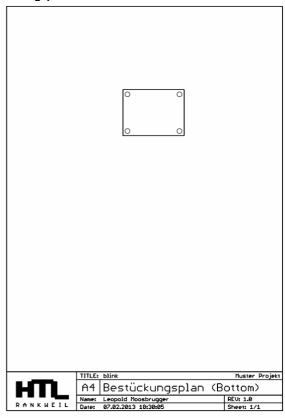
## Beispielprojekt Schaltplan



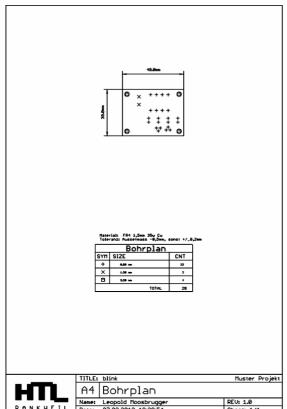
#### Bestückungsplan Oberseite



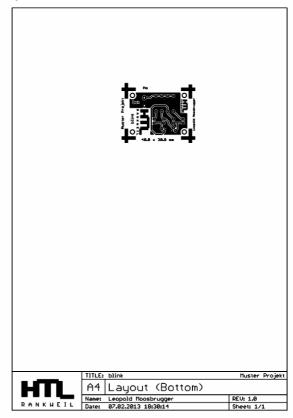
#### Bestückungsplan Unterseite



#### Bohrplan



#### **Layout Unterseite**



#### **EAGLE 5.11.0 Kurzanleitung**

Diese Unterlagen sind nur für den Gebrauch im Unterricht an der HTL-Rankweil bestimmt

# Erstellung eines Device, Package, Symbol durch kopieren und abändern eines vorhandenen Device

Device: besteht aus Package und Symbol

Package: Bauteil auf der Leiterplatte Symbol: Schaltplansymbol

1) Neue Bibliothek	anleg	gen
Control Panel: Datei/Neu/Library Datei/Speichern		Eigene Bibliothek (Library) anlegen und unter dem richtigen Pfad/Dateiname abspeichern
Vorhandens De	vice k	
Datei/Öffnen/Library		Im Control Panel eigene Bibliothek öffen
⊕- Bibliotheken		Im Control Panel gewünschte Bibliothek öffen RMT auf gewünschtes Device, <i>In Bibliothek kopieren</i>
3) Package kopier	en un	
Datei/Öffnen/Library		Im Control Panel vorhandene Bibliothek öffen
	2124	Package öffnen Edit Pac Neu: Name OK
Bearbeiten/Group Bearbeiten/Cut		Zu änderndes Package öffnen und in die Zwischenablage kopieren: Package öffnen <i>Edit Pac</i> zu änderndes Package <i>OK</i> mit LMT Part gruppieren Cut mit RMT Gruppe im Verschiebepunkt anklicken
Bearbeiten/Paste		Neues Package öffnen Edit Package OK Package einfügen.
Ansicht/Raster		Raster einschalten, mit 0.05 Inch zeichnen!
Bearbeiten/Delete Bearbeiten/Wire Bearbeiten/Arc Bearbeiten/Circle	VVCO	Part bearbeiten Layer 21 (tPlace), Width 0.006 Inch
Bearbeiten/Change /Size /Font /Ratio	15	Name und Value bearbeiten: Name: Size 0.05 Inch Ratio 10% Font Proportional Layer 25 tNames Values: Size 0.05 Inch Ratio 10% Font Proportional Layer 27 tValues
Bearbeiten/Change /Diameter /Drill /Shape	Þ	Pad bearbeiten Siehe Bohrdurchmesser für Pads! Siehe Bohrdurchmesser für Pads! Pad-Form auswählen.
Bearbeiten/Description		Ev. Beschreibung für Part erstellen
Datei/Speichern		
4) Symbol kopiere	n und	ändern
Datei/Öffnen/Library	4	Im Control Panel vorhandene Bibliothek öffen
	<b>Ð</b>	Symbol öffnen Edit Sym Neu: Name OK
Bearbeiten/Group Bearbeiten/Cut	[]] &	Zu änderndes Symbol öffnen und in die Zwischenablage kopieren: Symbol öffnen Edit Sym zu änderndes Symbol OK mit LMT Part gruppieren Cut mit RMT Gruppe im Verschiebepunkt anklicken
Bearbeiten/Paste	Ð N	Neues Symbol öffnen Edit Sym OK Symbol einfügen.
Ansicht/Raster		Raster einschalten, mit 0.1 Inch zeichnen!
Bearbeiten/Delete Bearbeiten/Wire Bearbeiten/Arc Bearbeiten/Circle	XVCO	Part bearbeiten Layer 94 (Symbols), Width 0.01
Bearbeiten/Change /Size /Font /Ratio	14	Name und Value bearbeiten: Name: Size 0.07 Inch Ratio 8% Font Proportional Layer 95 Names Values: Size 0.07 Inch Ratio 8% Font Proportional Layer 96 Values
Datei/Speichern		
5) Device ersteller		
	D D	Device öffnen Edit Dev Neu: Name OK



		Package Neu Package auswählen οκ Prefix Referenzbezeichner R, C οκ Value On
Add/Symbol	4	Symbol auswählen und mit LMT am Referenzpunkt ablegen
		Connect sooft Connect anklicken bis alle Anschlüsse belegt sind
Bearbeiten/Description		Ev. Beschreibung für Device erstellen
Datei/Speichern		



#### Hilfreiche Scripts und ULPs

Scripts		
HTL_Print_Schematic.scr		Schaltplan drucken (Layer werden eingestellt)
HTL_Set_Grid_0.05inch.scr		Setzt das Raster auf inch und Linien (0.05 / 0.025)
HTL_Set_Grid_1mm.scr	Ten ::::	Setzt das Raster auf mm und Punkte (1 / 0.5)
HTL_Print_Drilling.scr		Bohrplan drucken (Layer werden eingestellt)
HTL_Print_Placement.scr		Bestückungsplan drucken (Layer werden eingestellt)
HTL_Print_Layout_bottom.s		Layout Unterseite drucken (Layer werden eingestellt)
HTL_Print_Layout_top.scr		Layout Oberseite drucken (Layer werden eingestellt)
HTL_New_Bord_A4-V.scr		Erstellt eine neues Boardblatt
HTL_Polygon_OFF.scr		Schaltet Ratsnest (Polygon füllen) ab
HTL_Polygon_ON.scr		Schaltet Ratsnest (Polygon füllen) ein
HTL_Work_bottom_top.scr	#	Schaltet alle Layer für doppelseitige Boards ein.
HTL_Work_bottom.scr		Schaltet alle Layer für einseitige (bedrahtet) Boards ein.
HTL_Work_top.scr	:[[	Schaltet alle Layer für einseitige (smd) Boards ein.
HTL_Delete_Drilling.scr		Löscht die Bohrlegende
ULPs		
HTL_Create_Drilling.ulp		Erzeugt eine Bohrlegende (siehe eigene Anleitung)
HTL_Create_BillOfMaterial.ulp		Erzeugt eine Stückliste im CSV-, TXT- oder HTML-Format.
HTL_Create_Board.ulp		Erzeugt die Platinenumrisse, Beschriftungen, Bemaßungen und Schneidkreuze
HTL_Set_Project_Globale_Attributtes.ulp		Legt die Beschriftung der Arbeitsblätter fest
HTL_eagle2svg-1.2.ulp		Erzeugt eine SVG-Grafikdatei des Projekts
HTL_Exp-Project-lbr.ulp		Exportiert die Bauteile (Bibliotheken) eines Boards als Script(s). Mit diesen
		Scripts kann eine Board-Bibliothek angelegt werden. (mit Replace müssen die
LITIO		getauscht werden.
HTL_Schematic_libs.ulp		Listet die verwendeten Bibliotheken aus dem Schaltplan auf.
HTL_Board_libs.ulp		Listet die verwendeten Bibliotheken aus dem Board auf.
HTL_library_drill_overview.ulp		Listet die verwendeten Bohrdurchmesser in Bibliotheken auf

#### Kurzbeschreibung der Funktionstasten und Befehle

1) F	unktion	stasten und Befehle zur Bildschirmdarstellung
3	F1	Hilfe.
$\bigcirc$	Alt+F2	FIT – Zeichnung formatfüllend
	F2	Neuzeichnen
<b>₽</b>	F3	Vergrößern
$\oplus$	F4	Verkleinern
	F5	Neues Zentrum am Mouse-Cursor
	F6	Raster ein-/ausblenden
<b>+1</b> →	F7	Move
	F8	Split
$\mathbb{K}^{\frown}$	F9	Befehl rückgängig machen
C4	F10	Rückgängigmachung aufheben

2) Kurzbeschreibung der Befehle			
Add	<b>₽</b>	fügt ein Element in eine Zeichnung ein; RMT rotiert Element	
Arc	7	zeichnet Kreisbögen; RMT ändert Richtungssinn	
Auto	#	routet eine Leiterplatte automatisch	
Bus		zeichnet Busse im Schaltplan	
Change	1/2	ändert Parameter; RMT selektiert Gruppe	
/Layer		Ebene der Leiterplatte	
/Width		Linienbreite	
/Size		Textgröße	
/Ratio		Textstärke	
/Text		Beschriftungstext	



/Diameter		Pad-Durchmesser
/Drill		Pad-Bohrdurchmesser
/Shape		Pad-Form
/Smd		SMD-Abmaße
/Direction		PIN-Richtung
/Function		PIN-Funktion u.s.w
Circle	0	zeichnet Kreise
Сору	* *	kopiert Bauteile oder Bauteilgruppen; RMT rotiert Element
Cut	o <del>€</del>	schreibt Gruppe in den Paste-Puffer
Delete	×	löscht Objekte und Elemente
Display		wählen sichtbare Layer aus
Drc	€	Design Rule Check, prüft die Leiterplatte
Erc	€.	Electrical Rule Check, prüft den Schaltplan
Errors	•	zeigt die Fehler, die in DRC gefunden wurden
Gateswap	<b>8</b> 3	vertauscht äquivalente Gates
Group	100	definiert eine Gruppe, Abschluss mit RMT
Hole	ii	fügt Bohrloch in Platine oder Package ein
Info	•	zeigt Daten eines Bauteiles an
	i	
Invoke	20	holt bestimmte Gates von Bauteilen
Junction	**	setzt Markierungspunkt für zusammengehörige Netzwerke
Label	ABC	beschriftet Busse oder Netze; RMT rotiert Text
Mark	Į+"	definiert Marke in der Zeichenfläche für relative Abstandsmessung
Mirror	E 3	spiegelt Objekte und Bauteile; RMT selektiert Gruppe
Miter	r	Wire-Verbindungsstellen abschrägen.
Move	<b>↔</b>	bewegt Objekte und Elemente; RMT rotiert
Name	R2	zeigt Namen an oder ändert sie
Net		zeichnet Netze in Schaltplänen
Optimize	/+	fasst Wire-Segmente zusammen
Paste	-	fügt Paste Puffer in Bild ein
Pinswap	<b>‡</b>	Vertauscht zwei äquivalente Pin
Polygon	<b>*</b> -1	zeichnet Polygonflächen; RMT ändert Knickwinkel
Ratsnest		optimiert die Länge von Luftlinien zwischen mehreren Anschlusspunkten
		fügt ein Rechteck mit den * * Diagonalen ein
Rectangle		
Replace	<b>0+</b> 0	tauscht verschiedene Bauteilformen aus verwandelt Leiterbahnen in Luftlinien (an PINs).
Ripup	1	` ,
Rotate	+	dreht Objekte und Bauteile um 90 Grad; RMT selektiert Gruppe
Route	7	routet aus Luftlinien Leiterbahnen.; RMT ändert den Knickwinkel
Show	•	markiert durch Aufhellung eine angeklickte Linie
Signal	/	definiert Signale
Smash	- E	bewegt die Platzhalter >name und >value
Split	7	fügt in eine Linie eine Knickstelle ein; RMT ändert Knickwinkel
Text	Т	fügt Text ein; rechte Maustaste rotiert Text
Value	R2 l0k	liest den Bauteilwert
Via	iok	fügt eine Durchkontaktierungsstelle ein
Wire	7	zeichnet Linie; RMT ändert Knickwinkel

#### Layer

LMT ... Linke Maustaste RMT ... Rechte Maustaste

1) Layout- und Package-Editor						
Nr.	Bezeichnung	Farbe	Bedeutung			
1	Top (t)	rt	Leiterbahnen Bestückungsseite			
2-15	Route 2-15	rt bl schraffiert	Zwischenlagen für Multilayer Platine			



16	Bottom (b)	bl	Leiterbahnen Lötseite
17	Pads	gn	Lötaugen von bedrahteten Bauelementen
18	Vias	gn	Durchkontakierungen für Leiterbahnen
19	Unrouted	ge	Signalverbindungen vor dem Routen (Luftlinien)
20	Dimension	ws	Umrisse der Leiterplatte, und Kreise für Holes
21	tPlace	gn	Bestückungsdruck oben, Zeichenblatt Bestückungsplan
22	bPlace	gn	Bestückungsdruck unten, Zeichenblatt Bohrplan
23	tOrigins	ws	Aufhängepunkte oben, weißes Kreuz mit MOVE bewegbar
24	bOrigins	ws	Aufhängepunkte unten, weißes Kreuz mit MOVE bewegbar
25	tNames	gr	Namen der Bauelemente (Serviceaufdruck) oben, z.B. R3 oder IC4
26	bNames	gr	Namen der Bauelemente (Serviceaufdruck) unten, z.B. R3 oder IC4
27	tValues	gr	Werte der Bauelemente, z.B. 1kOhm oder 7400, oben
28	bValues	gr	Werte der Bauelemente, z.B. 1kOhm oder 7400, unten
29	tStop		Lötstoppmaske oben
30	bStop		Lötstoppmaske unten
31	tCream		Lötpaste oben
32	bCream		Lötpaste unten
33	tFinish		Veredelung oben, z.B. Vergoldung
34	bFinish		Veredelung unten, z.B. Vergoldung
35	tGlue		Klebemaske oben
36	bGlue		Klebemaske unten
37	tTest	gr	Test und Abgleichinformationen oben
38	bTest	gr	Test und Abgleichinformationen unten
39	tKeepout		Sperrfläche für Bauteile oben
40	bKeepout		Sperrfläche für Bauteile unten
41	tRestrict		Sperrfläche für Leiterbahnen oben, z.B. um Montagebohrungen
42	bRestrict		Sperrfläche für Leiterbahnen unten, z.B. um Montagebohrungen
43	vRestrict		Sperrfläche für Durchkontaktierungen (Via)
44	Drills	gr	Bohrungen, durchkontaktiert, Bohrsymbole
45	Holes	bl	Montagebohrungen, nicht durchkontaktiert, Bohrlegende
46	Milling	gr	CNC Fräserdaten zum Schneiden dr Platine
47	Measurement	gr	Bemaßungen
48	Document	gr	Dokumentation
49	Reference	gr	Passermarken Passermarken
51	tDocu		Detaillierter Bestückungsdruck oben
52	bDocu		Detaillierter Bestückungsdruck oben
101	tFrame	gn	Arbeitsplatt, Beschriftung
102	bFrame	gn	Arbeitsplatt, Beschriftung
144	Drill	gn	Bohrlegende

2) Ir	2) Im Schaltplan-, Symbol- und Device-Editor					
91	Nets	gn	Netze, Verbindungslinien			
92	Busses	bl	Busleitungen			
93	Pins	gn	Pins an den Bauelementen, mit Zusatzinformationen			
94	Symbols	rt	Symbole für Bauelemente			
95	Names	gr	Namen der Bauelemente z.B. R3 oder IC4			
96	Values	gr	Werte der Bauelemente z.B. 1kOhm oder 7400			
100	Frame	rt	Arbeitsplatt, Beschriftung			

### **Hinweis zu den neuen Layer** Um die neuen Arbeitsblätter zu nutzen, sind die Bibliotheken zu aktualisieren.

"Bibliothek / Aktualisieren..." oder "Bibliothek / Alles aktualisieren"

oder

die alten Blattrahmen löschen und neu im Schaltplan einfügen (siehe "Erstellen eines Pojekts")